

2024年度 製造中核人材育成セミナー日程

	1日目 (火)	(プロセス)	2日目 (水)	(プロセス)	3日目 (木)	(プロセス)	4日目 (金)	(プロセス)	
9:00			プロセス講義	37. p-ch S/Dフォトリソ	プロセス講義 実習生プロセス ・フォトリソ (3回目)	46.コンタクトフォトリソ	プロセス講義	52. 配線フォトリソ	
10:00			実習生プロセス ・フォトリソ (2回目) ・イオン注入	38. p-ch S/Dインプラ	周辺装置実習 ・マスキング露光装置		実習生プロセス ・フォトリソ (4回目)	53. Alエッチング	
	開始 10:30 御挨拶 (中村センター長)	予備時間			CRユーティリティ見学		実習生プロセス ・エッチング (Metal-RIE) ・レジスト除去 (WET) ・Alシタリング	54. フォトレジスト除去	
	オリエンテーション				休憩				
11:00	安全教育			デバイス講義	39. フォトレジスト除去	館内・館外ユーティリティ見学		CMOSプロセス実習 まとめ (CMSスタッフ)	
12:00	クリーンルーム入室・見学	予備時間	昼食 Lunch	40.n-ch S/Dフォトリソ 41. n-ch S/Dインプラ 42. フォトレジスト除去	昼食 Lunch	予備時間	昼食 Lunch	予備時間	
	予備時間								
13:00	予備時間			設計講義		プロセス講義		周辺装置実習 ・タイサー ・ワイヤーボンディング	
	プロセス講義	34.ゲートフォトリソ	プロセス講義	43. RCA洗浄	実習生プロセス ・エッチング (Si-RIE, BHF) ・フォトレジスト除去 ・スパッタリング	47. 酸化膜エッチング (RIE) 48. 酸化膜エッチング (Wet) 49. フォトレジスト除去	休憩 測定実習説明 ・測定デバイス、結果予測など		
	実習生プロセス ・フォトリソ (1回目)			休憩			50. HF洗浄 51. Al堆積	測定実習 ・nMOS、pMOS静特性 ・インバータ静特性 ・リングオシレータ測定	実習データとりまとめ
15:00	予備時間			実習生プロセス ・RCA洗浄 ・拡散炉		休憩			
	休憩	35.Poly-Siエッチング 36.フォトレジスト除去	実習生プロセス ・PE-CVD ・膜厚測定	44.S/D活性化熱処理 45.酸化膜堆積	周辺装置実習 FIB-SEM ・FIB-SEMの紹介 ・既存CMOSチップの観察、FIB加工		まとめ (中村センター長) 修了証授与 終了16:00		
16:00	実習生プロセス ・エッチング (Metal-RIE) ・フォトレジスト除去 (PR)					プロセス講義			
17:00	Q&A (自由参加)		予備時間	Q&A (自由参加)	予備時間	Q&A (自由参加)	予備時間		

座学など (AV講義室)
CMOSプロセス実習 (CR)
周辺装置実習・見学
昼食・休憩

注意：セミナーの進捗状況によりスケジュールが変更になる場合がございます。